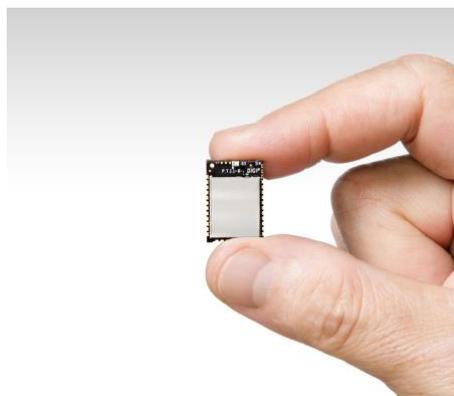


## Digi International stellt die neue Digi XBee3-Serie von Smart Edge IoT-Modulen und Modems vor

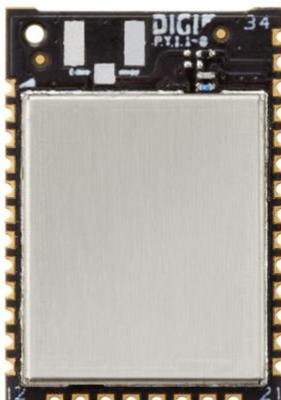
*Mit NEUEM Micro-Formfaktor; RF-Module und Mobilfunkmodems ermöglichen Programmierbarkeit und flexible Architektur und bieten modulare Agilität für zukunftsweisende IoT Edge-Konnektivität*

**MINNETONKA, Minn., 30. Januar 2018** – Digi International®, (NASDAQ: DGII, [www.digi.com](http://www.digi.com)), ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen auf dem Gebiet der IoT-Connectivity, kündigte heute die Verfügbarkeit der Digi XBee3™ Serie von RF-Modulen und Mobilfunkmodems der nächsten Generation an. Die Digi XBee3 Serie erweitert ihren modularen Ansatz für die IoT-Konnektivität um eine neue Micro-Formfaktor-Option, die größere IoT-Innovationen am Netzwerkrand unterstützt und die Integration neuer Funktionen ermöglicht, je nach Bedarf und regionalen Anforderungen. Auch mit seiner Micro-Größe bietet das Digi XBee3 MicroPython-Programmierbarkeit und Dual-Mode-Funkmodule, die drahtlose Designflexibilität bieten, und ermöglicht problemlos zusätzliche Funktionalität für innovative IoT-Lösungen, die schneller entwickelt, prototypisiert und in Serie produziert werden können.



### Micro-, SMT- und Through-hole-Formfaktoren

Mit einem Drittel der Größe des ursprünglichen Digi XBee RF-Moduls ist das Digi XBee3 Micro-Formfaktor (13 mm x 19 mm) eines der kleinsten MicroPython-programmierbaren Module der Branche, das RF-Konnektivität für Anwendungen mit kurzer Reichweite und Low Power Wide Area Network (LPWAN) bietet.



Das Digi XBee3 micro, das auch in den bewährten Digi XBee SMT- und Through-Hole-Formfaktoren erhältlich ist, bietet bei der Installation auf Interposer-Boards automatisch alle Vorteile des branchenweit kleinsten RF-Moduls, das die Entwicklung wirklich innovativer, intelligenter IoT-Lösungen unterstützt. Darüber hinaus ist der Through-Hole-Formfaktor ideal als Validierungs- und Migrationsplattform für alle, die die erweiterten Funktionen und Eigenschaften benötigen, um die Entwicklung, das Prototyping oder die frühe Produktionsphase zu beschleunigen. Digi XBee3 Cellular ist in

seinem originalen, klassischen Through-hole-Formfaktor verfügbar.

### Mikromodule mit großartigen Eigenschaften

Die Digi XBee3-Serie ist mit ihrer geringen Größe, ihrem geringen Gewicht und ihrem geringen Stromverbrauch ideal für kompakte und batteriebetriebene Anwendungen geeignet. Digi XBee3 bietet mehrere Ebenen der Programmierbarkeit, darunter Dual-Mode-Funkgeräte, MicroPython für Geschäftsregeln und Anwendungslogik sowie die Tools zur Verwaltung aller Funktionen. Zusätzlich zur Edge-Programmierbarkeit bietet es einen Low-Power-Mikrocontroller, der in der Lage ist,

Intelligenz am Netzwerkrand zu liefern, und die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Protokollen zu wechseln, ohne das Gerät zu modifizieren.

Mit dem integrierten Digi TrustFence® Sicherheits-Framework bieten alle Digi XBee3-Produkte U.FL-, Pad- oder Chip-Antennenoptionen.

### **Flexibilität in der Gestaltung**

Die Digi XBee3-Serie wird zunächst sowohl in der RF-Option (ZigBee 3.0, IEEE 802.15.4) als auch in der Mobilfunkoption (Cellular Cat-1) erhältlich sein. In den nächsten Monaten wird Digi XBee3 mittels Software-Upgrade auf Bluetooth LE aufrüstbar sein und auch mit weiteren RF-Protokollen (DigiMesh® und Wi-Fi) sowie zwei Mobilfunkmodems (Cellular LTE-M und Cellular NB-IoT) verfügbar sein.

### **Digi XBee3 – Zukunftsweisende Eigenschaften**

- Einfache Over-the-Air (OTA)-Änderungen an Geräten im Außeneinsatz für Bugfixes und neue Funktionen
- Dynamisch rekonfigurierbar, situationsabhängig
- Einfaches Definieren von Geschäftsregeln zum Aggregieren, Speichern, Transformieren und Filtern von Daten über die MicroPython-Programmierfunktionalität
- Erstellen von Warnmeldungen und Alarmen für Prioritätsdaten und Gerätezustand
- Integrierte Unterstützung für leistungsstarke I/O-Funktionen – einschließlich I2C und SPI – zur Ansteuerung moderner Sensoren und Aktoren
- Steuerlogik für Bausteine, die einen Mikrocontroller benötigen, ohne Neukonstruktion der Elektronik
- Der Digi Remote Manager® ermöglicht ein besseres Bandbreitenmanagement über einer Priorisierung / Übertragung relevanter Informationen
- Dynamische Verhaltensänderungen, wie sie von Cloud-Plattformen wie AWS und Azure gefordert werden (z. B. Ermöglichung von Echtzeit-Entscheidungen auf Basis der lokalen Bedingungen)
- Betrieb auch bei Kommunikationsausfällen durch dynamisch ausgeführte Logik, die nicht von der Cloud abhängt

### **Verfügbarkeit des Entwicklungs-Kits**

Das Digi XBee3 ZigBee Mesh Kit ist für Evaluierungen und Tests verfügbar. Das Kit enthält drei Digi XBee3-Module sowie drei Digi XBee Grove Development Boards, die es Kunden ermöglichen, ein direkt einsatzfähiges ZigBee Mesh-Netzwerk zu erstellen.

„Mit der Entwicklung des Digi XBee3 haben wir fortschrittliche Funktionen und Flexibilität in einem Mikroformfaktor kombiniert, um das allererste 'Smart Edge'-IoT-Modul anzubieten“, sagte Scott Nelson, Vice President of Product bei Digi. „Da die Intelligenz immer weiter an den Rand von IoT-Netzwerken rückt, benötigt der Markt Hardware, die sehr leistungsfähig, sehr anpassungsfähig, sicher und erweiterbar ist. Mit dem Digi XBee3 stellen wir ein Modul bereit, das Lösungen liefern kann, die in der Lage sind, Daten dort zu aggregieren und zu analysieren, wo sie in einem verteilten Netzwerk erfasst werden, und spezifische Geschäftsregeln und Anwendungslogik anzuwenden - im Wesentlichen die nächste Generation von IoT-Anwendungen.“

Weitere Informationen zum Digi XBee3 finden sie unter <https://www.digi.com/pr/xbee3>

### **Bilder**

“The new, micro-sized (13mm x 19mm) Digi XBee3 series of programmable, smart edge modules.”

- <http://www.catalystforcontent.com/uploads/simplex/images/pr/images/digi-xbee3-black-micro-rfpad-straight.jpg>
- <http://www.catalystforcontent.com/uploads/simplex/images/pr/images/digi-xbee3-hand.jpg>

### **Über Digi International**

Digi International (NASDAQ: DGII) ist ein weltweit führender Anbieter geschäftskritischer Machine to Machine (M2M) und Internet of Things (IoT) Verbindungslösungen und Dienstleistungen. Wir helfen unseren Kunden bei der Schaffung der nächsten Generation vernetzter Produkte und der Implementation und Verwaltung kritischer Kommunikationsinfrastrukturen in anspruchsvollen Umgebungen mit einem hohen Maß an Sicherheit, mit kompromissloser Verlässlichkeit und höchster Leistungsfähigkeit. Seit unserer Gründung im Jahr 1985 haben wir unseren Kunden bei der Verbindung von mehr als 100 Millionen Dingen geholfen und die Zahl wächst ständig. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Digi unter [www.digi.com](http://www.digi.com) oder telefonisch unter 877-912-3444 (USA) oder 952-912-3444 (international).

### **Medienkontakt:**

Joseph Rigoli

LEWIS

Geschäftsstelle: +1 781-418-2400

[Digi@teamlewis.com](mailto:Digi@teamlewis.com)